

有研半导体材料股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

● 本次重大资产重组尚需满足多项前置条件方可实施，包括但不限于公司董事会和股东大会审议通过本次重大资产重组事项、国务院国资委批准本次重大资产重组事项、中国证监会核准本次重大资产重组事项等。上述前置条件能否满足、将于何时满足均存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

● 截至本公告披露之日，公司董事会未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

● 自公司 2013 年 6 月 14 日公告《有研半导体材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以来，公司未与交易对方签署与本次重大资产重组有关的协议。

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 13 日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于审议〈有研半导体材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于 2013 年 6 月 14 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告，公司股票于 2013 年 6 月 14 日复牌。2013 年 7 月 13 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《重大资产重组进展公告》。现将本次重大资产重组

进展情况公告如下：

- 1、公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作；
- 2、资产评估工作已基本完成，正在履行国资备案审核程序；
- 3、盈利预测报告和备考财务报表的审核工作已基本完成；

4、自公司 2013 年 6 月 14 日公告《有研半导体材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以来，公司未与交易对方签署与本次重大资产重组有关的协议。

根据相关法规，公司将在完成评估报告国资备案程序、盈利预测和备考财务报表审核后，再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并发出召开股东大会审议本次重大资产重组事项的通知，在发出上述股东大会通知前，公司董事会将每隔 30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《有研半导体材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露。截至本公告披露之日，公司董事会未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

上述事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013 年 8 月 13 日